



中华人民共和国国家标准

GB/T 5967—2011/IEC 60384-8-1:2005
代替 GB/T 5967—1996

GB/T 5967—2011/IEC 60384-8-1:2005

电子设备用固定电容器 第 8-1 部分:空白详细规范 1 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ

Fixed capacitors for use in electronic equipment—
Part 8-1: Blank detail specification: Fixed capacitor of ceramic dielectric,
Class 1—Assessment level EZ

(IEC 60384-8-1:2005, IDT)

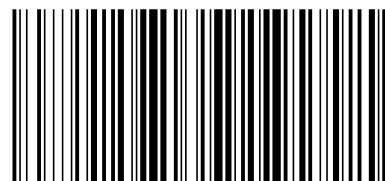
中华人民共和国
国家标准
电子设备用固定电容器
第 8-1 部分:空白详细规范
1 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ
GB/T 5967—2011/IEC 60384-8-1:2005

*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 20 千字
2012 年 6 月第一版 2012 年 6 月第一次印刷

*
书号: 155066·1-45111 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 5967-2011

2012-12-30 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

表 6 (续)

条款号和试验项目 ^a	D 或 ND	试验条件 ^a	样品数和 允许不合格品数 ^b			性能要求 ^a
			<i>p</i>	<i>n</i>	<i>c</i>	
C4 分组 4.3 温度系数和循环漂移	ND	条件:预先干燥 16 h~24 h	12	9	0 ^f	ΔC/C 按 4.3.3
^a 试验项目和性能要求的条款号是引自分规范 GB/T 5966—2011 和本部分中第 1 章。 ^b 在本表中: <i>p</i> =周期(月); <i>n</i> =样品数; <i>c</i> =允许不合格品数;D=破坏性的;ND=非破坏性的; <i>IL</i> =检验水平。 ^c 为了用每百万分之不合格产品数(10 ⁻⁶)来监测产品的出厂质量水平,应在 100%检验后抽样复验。抽样水平应由制造厂家决定。计算 10 ⁻⁶ 数值时,任何一个参数失效都应当算作一个不合格项,在一个样本中存在一个或多个不合格项时,这批产品就应当被拒收。 ^d 检验水平和 AQL(合格质量水平)选自 IEC 60410 计数检查抽样方案和程序。 ^e 如果生产厂家在生产过程中对尺寸方面采用了 SPC 技术或其他途径以避免尺寸超差,则该检验可以用生产检验来代替。 ^f 如果分组试验中有一个项目不合格,允许用一组新的样本重新进行该分组试验,并不允许有不合格项目。在重新试验期间不影响产品的放行。 ^g 如果介质材料的每一生产批已进行过相应的试验,则本检验组可以省略。						

前 言

《电子设备用固定电容器》系列国家标准分为如下若干部分:

- 第 1 部分:总规范(GB/T 2693—2001/IEC 60384-1:1999);
- 第 2 部分:分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 7332—2011/IEC 60384-2:2005);
- 第 2-1 部分:空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(IEC 60384-2-1:2005);
- 第 3 部分:分规范 表面安装 MnO₂ 固体电解质钽固定电容器(IEC 60384-3:2007);
- 第 3-1 部分:空白详细规范 表面安装 MnO₂ 固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-3-1:2007);
- 第 4 部分:分规范 固体和非固体电解质铝电解电容器(GB/T 5993—2003/IEC 60384-4:1998,第 1 号修改单:2000);
- 第 4-1 部分:空白详细规范 非固体电解质铝电解电容器 评定水平 EZ(GB/T 5994—2003/IEC 60384-4:2000);
- 第 4-2 部分:空白详细规范 固体电解质铝电解电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-4-2:2007);
- 第 6 部分:分规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器(IEC 60384-6:2005);
- 第 6-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器 评定水平 E(IEC 60384-6-1:2005);
- 第 7 部分:分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10185);
- 第 7-1 部分:空白详细规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(可供认证用)(GB/T 10186);
- 第 8 部分:分规范 1 类瓷介固定电容器(GB/T 5966—2011/IEC 60384-8:2005);
- 第 8-1 部分:空白详细规范 1 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5967—2011/IEC 60384-8-1:2005);
- 第 9 部分:分规范 2 类瓷介固定电容器(GB/T 5968—2011/IEC 60384-9:2005);
- 第 9-1 部分:空白详细规范 2 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-9-1:2005);
- 第 11 部分:分规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-11:2008);
- 第 11-1 部分:空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-11-1:2008);
- 第 12 部分:分规范 金属箔式聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-12:1988);
- 第 12-1 部分:空白详细规范 金属箔式聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(IEC 60384-12-1:1988);
- 第 13 部分:分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-13:2006);
- 第 13-1 部分:空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(IEC 60384-13-1:2006);
- 第 14 部分:分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器(GB/T 14472—1998/IEC 60384-14:1993,第 1 号修改单:1995);

- 第 14-1 部分:空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平 D(GB/T 14473—1998/IEC 60384-14-1:1993);
- 第 15 部分:分规范 非固体或固体电解质钽电容器(GB/T 7213—2003/IEC 60384-15:1982, 第 1 号修改单:1987,第 2 号修改单:1992);
- 第 15-1 部分:空白详细规范 非固体电解质箔电极钽电容器 评定水平 E(可供认证用)(GB/T 12794—1991/IEC 60384-15-1:1984);
- 第 15-2 部分:空白详细规范 非固体电解质多孔阳极钽电容器 评定水平 E(可供认证用)(GB/T 12795—1991/IEC 60384-15-2:1984);
- 第 15-3 部分:空白详细规范 固体电解质和 多孔阳极钽电容器 评定水平 E(GB/T 7214—2003/IEC 60384-15-3:1992);
- 第 16 部分:分规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器(IEC 60384-16:2005);
- 第 16-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 10191—2011/IEC 60384-16-1:2005);
- 第 17 部分:分规范 金属化聚丙烯薄膜介质交流和脉冲固定电容器(IEC 60384-17:2005);
- 第 17-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平 E 和 EZ(IEC 60384-17-1:2005);
- 第 18 部分:分规范 固体(MnO₂)和非固体电解质片式铝固定电容器(GB/T 17206—1998/IEC 60384-18:1993,第 1 号修改单:1998);
- 第 18-1 部分:空白详细规范 表面安装固体(MnO₂)电解质铝固定电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-18-1:2007);
- 第 18-2 部分:空白详细规范 非固体电解质片式铝固定电容器 评定水平 E(GB/T 17208—1998/IEC 60384-18-2:1993);
- 第 19 部分:分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质表面安装直流固定电容器(IEC 60384-19:2006);
- 第 19-1 部分:空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质表面安装直流固定电容器 评定水平 E(IEC 60384-19-1:2006);
- 第 21 部分:分规范 表面安装 1 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21041—2007/IEC 60384-21:2004);
- 第 21-1 部分:空白详细规范 表面安装 1 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 21038—2007/IEC 60384-21-1:2004);
- 第 22 部分:分规范 表面安装 2 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21042—2007/IEC 60384-22:2004);
- 第 22-1 部分:空白详细规范 表面安装 2 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 21040—2007/IEC 60384-22-1:2004)。

本部分为《电子设备用固定电容器》系列国家标准的第 8-1 部分。

本标准按 GB/T 1.1—2009 和 GB/T 20000.2—2009 给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用 IEC 60384-8-1:2005《电子设备用固定电容器 第 8-1 部分:空白详细规范 1 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ》。

为了便于使用,对 IEC 60384-8-1:2005 进行了一些编辑性修改。

本部分是对 GB/T 5967—1996 进行的第 1 次修订,与 GB/T 5967—1996 相比,主要差异如下:

——由评定水平 E 变更为评定水平 EZ。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会(SAC/TC 165)归口。

表 6 (续)

条款号和试验项目 ^a	D 或 ND	试验条件 ^a	样品数和 允许不合格品数 ^b			性能要求 ^a
			<i>p</i>	<i>n</i>	<i>c</i>	
C1 分组 C1A 和 C1B 分组样品的 总和 4.11 气候顺序 4.11.2 干热 4.11.3 循环湿热,试验 Db,第一个循环 4.11.4 寒冷 4.11.5 低气压(如果详细 规范有要求) 4.11.5.3 中间检验 4.11.6 循环湿热,试验 Db,其余循环 4.11.6.3 最后测量	D	温度:上限类别温度 持续时间:16 h 温度:下限类别温度 持续时间:2 h 外观检查 气压:8 kPa 外观检查 恢复:6 h~24 h 外观检查 电容量 损耗角正切 绝缘电阻	6	27	0 ^f	无可见损伤 无击穿或飞弧 无可见损伤,标志清晰 ΔC/C 按 4.11.6.3 按 4.11.6.3 按 4.11.6.3
C2 分组 4.12 稳态湿热 4.12.1 初始测量 4.12.5 最后测量	D	电容量 恢复:6 h~24 h 外观检查 电容量 损耗角正切 绝缘电阻	6	15	0 ^f	无可见损伤,标志清晰 ΔC/C 按 4.12.5 按 4.12.5 按 4.12.5
C3 分组 4.13 耐久性 4.13.1 初始测量 4.13.4 最后测量	D	电压:... V 持续时间:... h 电容量 恢复:6 h~24 h 外观检查 电容量 损耗角正切 绝缘电阻	3	15	0 ^f	无可见损伤,标志清晰 ΔC/C 按 4.13.4 按 4.13.4 按 4.13.4